

Title (en)  
Process for metallizing a compact body.

Title (de)  
Verfahren zur Metallisierung eines festen Körpers.

Title (fr)  
Procédé de métallisation d'un corps compact.

Publication  
**EP 0132784 A2 19850213 (DE)**

Application  
**EP 84108494 A 19840718**

Priority  
DE 3326253 A 19830721

Abstract (en)  
[origin: WO8500623A1] For the secure adherence of the metallization of a preferably glass-like body, a catalytic germination layer, for the chemical currentless separation of metal after a first thin layer of an indium-tin alloy, is produced by reducing a catalyst metal combination to the catalyst metal directly through the indium-tin layer or after a salt formation and hydrolysis of the indium-tin layer. After the chemical currentless metallization it is possible to proceed with the metallization by galvanization using the presently usual metals.

Abstract (de)  
Zur haftfesten Metallisierung eines vorzugsweise glasartigen Körpers wird nach einer dünnen Beschichtung mit einer Indium-Zinn-Legierung eine für die stromlos-chemische Metallabscheidung katalytische Keimschicht erzeugt, indem eine Katalysatormetallverbindung durch die Indium-Zinn-Schicht direkt oder nach einer Salzbildung und Hydrolyse der Indium-Zinn-Schicht durch diese zum Katalysatormetall reduziert wird. Nach der stromlos-chemischen Metallisierung kann mit derzeit üblichen Metallen galvanisch weiterverstärkt werden.

IPC 1-7  
**C23C 18/18**

IPC 8 full level  
**C03C 17/40** (2006.01); **C23C 18/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**C23C 18/165** (2013.01 - EP US); **C23C 18/1851** (2013.01 - EP US); **C23C 18/1879** (2013.01 - EP US)

Cited by  
EP0279432A3; EP0220541A1; US4726965A

Designated contracting state (EPC)  
IT

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0132784 A2 19850213; EP 0132784 A3 19850320**; DE 3326253 A1 19850131; DE 3476820 D1 19890330; DK 42585 A 19850322; DK 42585 D0 19850131; EP 0149662 A1 19850731; EP 0149662 B1 19890222; JP S60501858 A 19851031; US 4692356 A 19870908; WO 8500623 A1 19850214

DOCDB simple family (application)  
**EP 84108494 A 19840718**; DE 3326253 A 19830721; DE 3476820 T 19840718; DK 42585 A 19850131; EP 8400223 W 19840718; EP 84902802 A 19840718; JP 50286384 A 19840718; US 70367985 A 19850211